ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

Advantech (TWSE:2395)

3Q 2026 Investor Conference Call Transcript (Summary)

-Hosted by Daiwa Cathay Capital Markets.

Date: November 4, 2026 | Time: 15:30 Taipei Time

3Q26 Revenue	Gross Margin	Operating Margin	EPS (NTD)
$32.440 BN	**36.7%**	**20.9%**	**$7.15**
+83% YoY			

CALL PARTICIPANTS

Corporate Executives

- **Eric Chen**– CFO & President of General Management
- **Miller Chang**– *President of Embedded Sector*
- **Grace Liao**– *Deputy Spokesperson and Sr. IR Manager*

SAFE HARBOR STATEMENT & FORWARD-LOOKING DISCLAIMER

This transcript has been prepared based on the audio recording of the conference call and has been edited for clarity and readability, including the removal of repetitive wording and conversational fillers. While reasonable efforts have been made to ensure its accuracy, the transcript may contain transcription errors or omissions. In the event of any discrepancy, the original audio recording and the Company's official filings and disclosures shall prevail. This transcript is provided for reference only and does not constitute investment advice or an offer or solicitation to buy or sell any securities.

MANAGEMENT PRESENTATION

Grace Liao– *Deputy Spokesperson and Sr. IR Manager*

研華 2026 年第三季營收及獲利雙雙創下歷史新高。第三季營收為新台幣 324.40 億元，年增 83%、季增 24%；毛利為新台幣 119.00 億元，毛利率 36.7%，主要受到關鍵零組件成本上漲影響。營業利益達新台幣 68.00 億

元，營業利益率 20.9%。營業外淨收益為新台幣 11.10 億元，主要來自股利收入及處分日本辦公大樓的一次性利益。第三季有效稅率為 21.5%；稅後淨利達新台幣 62.20 億元，年增 125%，單季每股盈餘（EPS）為新台幣 7.15 元。

2026 年前三季累計營收達新台幣 789.50 億元，年增 49%；毛利為新台幣 297.20 億元，毛利率 37.6%，年減 2.2 個百分點。營業利益達新台幣 156.50 億元，營業利益率 19.8%，營業利益年增 79%。前三季稅後淨利達新台幣 140.70 億元，年增 88%，累計每股盈餘為新台幣 16.21 元。

以美元計價，2026 年前三季營收為 24.90 億美元，年增 46%，所有區域市場均達到雙位數成長。北美、歐洲及中國合計持續貢獻約 70%的總營收。北美營收年增 58%，主要由半導體設備、機器人及雲端基礎設施專案帶動；歐洲年增 36%，主要受惠於工廠自動化及醫療設備專案；中國年增 55%，得益於通路銷售強勁，以及半導體設備、自動化和智慧能源應用需求。台灣年增 72%，主要由半導體設備、自動化及交通運輸專案推動。北亞及新興市場營收亦分別年增 43%與 37%。

依事業群劃分，物聯網自動化事業群營收成長 25%，受惠於北美、中國及台灣的工廠自動化專案，以及交通運輸應用；智能系統事業群成長 49%，主要來自半導體設備、雲端基礎設施、機器人及 AI 相關專案；嵌入式事業群成長 40%，受惠於北美、歐洲、中國、中東及非洲的醫療設備需求，以及機械自動化與關鍵任務應用；智能服務事業群成長 7%，醫療照護專案強勁成長，但部分受到零售及餐旅業務下滑抵銷。

資產負債表方面，現金及約當現金占總資產 18%，因發放現金股利而較前一季略為下降；存貨占總資產 23%，與前一季大致持平。存貨週轉天數改善至 95 天，現金轉換週期為 86 天。兩項指標均維持在合理範圍，反映公司財務結構穩健、資金運用效率穩定。

Eric Chen– *CFO* & President of General Management

第三季營收首次突破 10 億美元，創下單季新高。毛利率由第二季下滑約 1.00 個百分點至 36.67%，主要因 SSD、DDR4 記憶體及其他關鍵零組件成本大幅上漲。研華雖已將增加的成本轉嫁給客戶，但由於相關零組件價格透明、加價幅度有限，難以維持過往的毛利率水準。儘管如此，第三季營業利益率仍達 20.95%，反映銷售量增加及營業費用控管得宜。前三季營業費用率降至 17.82%，較去年同期改善約 5.43 個百分點。

美國、中國及台灣市場持續表現強勁，營收分別年增 58%、55%及 72%。美國市場受半導體及醫療設備應用需求帶動，區域訂單出貨比（B/B Ratio）達 2.12；中國受惠於半導體設備、工廠自動化及醫療照護相關應用；台灣則主要由半導體設備帶動。日本及韓國的成長幅度大致與公司整體平均相當。產品組合方面，智能系統及嵌入式運算維持高度成長，需求來自半導體設備、影像相關應用及醫療設備；服務相關業務亦受惠於記憶體及儲存產品需求。

第三季整體訂單出貨比（B/B Ratio）為 1.64；北美及歐洲分別為 2.12 及 1.52，而中國依公司官方財報新聞稿所揭露的數據為 1.50。自 2025 年第三季起，接單連續五季成長；自 2025 年第四季起，出貨連續四季成長，顯示接單與出貨動能持續正向。半導體設備應用的強勁需求，也持續提升未來訂單的能見度。

管理階層提供的 2026 年第四季營收指引為 9.70 億至 9.90 億美元，採用新台幣兌美元 31.80 元的匯率假設；毛利率預估為 36.0%至 38.0%，營業利益率為 18.0%至 20.0%。

QUESTION & ANSWER SESSION

本次會議問答主題係依據公司持續與投資界交流過程中提出的主要議題彙整，包括但不限於大和證券（Daiwa）提問。

Financial, BB Ratio & Outlook

[1.1] 應如何看待短期需求？能否進一步說明 2026 年第三季及 10 月的訂單出貨比（B/B Ratio）？最新的設計導入（Design-in）及設計定案（Design Win）數量有何更新？
[1.2] 面對目前的成本通膨趨勢，未來產品價格將如何變動？對 2026 年第四季及往後的毛利率趨勢有何影響？
[1.3] 市場擔心成本上漲可能促使客戶提前下單。能否進一步說明目前的在手訂單，以及其中有多少需求可能是提前拉貨所致？
[1.4] 隨著 Edge AI 營收貢獻預期在 2026 年下半年及 2027 年提高，扣除成本通膨因素後，將如何影響平均售價（ASP）及毛利率？Edge AI 營收占比提高，對毛利率是正面還是負面影響？

Eric Chen– *CFO* & President of General Management

2026 年第三季整體訂單出貨比為 1.64，10 月為 1.60，主要受到北美、中國及台灣半導體設備強勁需求支撐。半導體產業的訂單出貨比達 2.62，北美及歐洲的醫療設備，以及中國的工業自動化亦展現正向接單動能。研華在美國取得 161 項設計定案（Design Win），預估年營收（EAR）約 6.87 億美元，年增 262%。

零組件成本上漲持續對毛利率造成壓力，部分 CPU 價格上漲 10%至 20%，PCB 價格上漲 15%至 20%。研華雖已調整售價以反映成本增加，但關鍵零組件的加價幅度較低，因而稀釋整體毛利率。預期 2026 年第四季毛利率維持在 36%至 38%，與第三季相近。隨著關鍵零組件價格及供貨配額逐漸趨於穩定，公司將有更大機會改善毛利率表現，長期目標仍是回升至接近 40%。

研華在手訂單約 25.0 億美元，涵蓋至 2027 年的交貨需求。由於零組件交期延長，客戶傾向提前下單以確保供應，而非要求提前出貨。考量研華產品通常仍需進一步整合至客戶系統，目前在手訂單並非主要由提前拉貨所推動。公司內部持續密切監控需求、供應、訂單遞延及取消情形，目前相關指標內部觀察仍維持正常。

而 Edge AI 產品，尤其是高階邊緣伺服器，可顯著提升整體平均售價（ASP）。然毛利率仍因不同應用領域及產品組合而異。其中特定醫療及工業 AI 解決方案通常具有較高毛利率；高階邊緣伺服器則因高成本周邊零組件占比較高，毛利率進而相對較低。

Key Components & Supply Condition

[2.1] 能否更新目前零組件短缺的情況，尤其是記憶體、晶片及 PCB？
[2.2] 2026 年前九個月的營收成長中，有多少來自銷售量增加，又有多少來自價格調漲？

Eric Chen– *CFO* & President of General Management

零組件供應情況仍具挑戰，但不同產品類別的狀況有所差異。主流記憶體供應已逐步趨於穩定，但受 AI 及資料中心需求強勁影響，部分規格品項（SKU）仍供應吃緊。部分 CPU 及晶片組，尤其是舊世代與嵌入式平台所使用的品項，仍受到配額供應限制，交期也較長。PCB 供應瓶頸主要集中於部分上游材料，尤其是銅箔基板（CCL）。研華透過提前採購、深化與策略供應商的合作，以及供應鏈多元化因應，部分供應限制可能延續至 2027 年。

2026 年前九個月，研華營收年增 49.1%，其中價格調漲貢獻 20.5 個百分點，銷售量成長貢獻其餘 28.6 個百分點。

Regional & Sector performances

[3.1] 如何看待北美（ANA）、歐洲（AEU）及中國（ACN）在 2026 年第四季與 2027 年的成長表現？各區域的主要成長動能為何？
[3.2] 如何看待美國半導體產業的需求展望？全球 AI 基礎設施的需求前景又如何？

Miller Chang– *President of Embedded Sector*

管理階層預期，受前三季營收表現及訂單出貨比支撐，強勁成長動能可望延續至 2026 年第四季。北美的主要成長動能包括半導體設備、AI 與雲端基礎設施、醫療設備及機器人；歐洲預期受惠於工業及醫療設備需求；中國則由工業自動化、半導體設備、醫療設備及新興機器人應用支撐。公司對 2027 年持正向看法。

半導體設備需求預期將持續強勁至 2027 年，主要受半導體產能及先進製造持續投資帶動。研華服務全球主要半導體設備製造商，涵蓋前段晶圓製程及後段封裝測試，相關商機由北美延伸至亞洲與歐洲。同時，全球 AI 基礎設施投資正帶動電力系統、能源管理、散熱及工業自動化等周邊設備需求。研華期望透過邊緣運算與工業伺服器平台掌握相關商機。

Edge AI progress

[4.1] 研華如何定義 Edge AI 營收？其中涵蓋哪些產品與解決方案？

Eric Chen– *CFO* & **President of General Management** & **Miller Chang**– *President of Embedded Sector*

研華將 Edge AI 營收定義為具備 GPU、NPU 或 TPU 運算能力、可支援 AI 推論工作負載的產品，涵蓋整合式 AI 運算產品，以及 GPU 顯示卡、AI 晶片等獨立 AI 零組件。2026 年前九個月，Edge AI 營收達 6.03 億美元，年增 109%，占總營收 24.5%。其中整合式產品約占 Edge AI 營收 95%，獨立零組件則占 5%。主要應用包括醫療影像、工廠自動化、光學檢測及機器人，並由研華的嵌入式運算平台、工業邊緣伺服器及軟體解決方案提供支援。不過，純 AI 軟體營收目前仍相對有限。

[4.2] 效能更高的嵌入式主機板能帶來哪些新應用？除了硬體效能外，研華如何與其他工業電腦（IPC）業者做出差異化？能否分享具體案例？

Miller Chang– *President of Embedded Sector*

醫療影像及工廠自動化是需要高效能嵌入式運算的主要應用。CT 及 MRI 系統愈來愈依賴 AI 進行影像處理、雜訊降低及異常偵測；自動光學檢測（AOI）則需要更高運算能力，以即時處理高解析度影像並辨識瑕疵。除硬體效能外，研華的差異化優勢包括遍及 27 個地區、超過 100 座城市的全球在地化技術服務，與主要半導體合作夥伴共同開發的完整邊緣運算產品組合，以及 WEDA 與 Integrated WISE Solutions（IWS）等軟體解決方案，協助客戶開發及部署工業 AI 應用。

Long-term Strategy

[5.1] 未來十年，研華的主要成長動能為何？Edge AI 與機器人業務有望發展到多大規模、扮演多重要的角色？
[5.2] 哪些工業應用正推動更高運算效能的需求？管理階層預期此需求將如何演變？

Eric Chen– *CFO* & **President of General Management** & **Miller Chang**– *President of Embedded Sector*

管理階層認為，半導體設備、工廠自動化及醫療設備是長期核心成長動能，Edge AI、機器人、能源基礎設施及關鍵任務應用則提供新興商機。研華目標在 2030 年前成為全球領先的 Edge AI 平台解決方案供應商，並透過軟體平台及生態系夥伴關係，將業務由硬體進一步延伸。公司約三年前成立專責機器人事業單位，2026 年機器人業務營收成長約 200%至 300%。雖然目前營收貢獻仍相對有限，但管理階層預期機器人及其他 AI 驅動應用將成為愈來愈重要的成長動能。

管理階層指出，半導體製造、醫療影像、工業自動光學檢測（AOI）及機器人，是推動高運算效能需求的主要應用。先進半導體製程需要更精密的檢測與測試；CT 及 MRI 系統愈來愈依賴 AI 影像處理與分析；工廠 AOI 應用

也需要更快速處理高解析度影像，以即時偵測缺陷。同時，機器人在環境感知、決策及動作控制方面需要更高運算能力。隨著應用日益複雜，管理階層預期需求將轉向整合式高效能運算平台、AI 加速器及工業邊緣伺服器。

Open Floor Q&A

[1] 第三季接單創新高、訂單出貨比達 1.6 倍，為何第四季營收指引仍預估季減？原因是供應或產能限制，還是需求問題？

Eric Chen– *CFO* & President of General Management

2026 年第四季的財測的基本基礎情境下，已考量年底假期以及 11 月全球 ERP 系統升級的預定停機時間，預期將影響部分工作天數，使其少營收略少於第三季。然需求仍持續增強，若執行順利，第四季營收仍有相當機會超越第三季，再次突破 10 億美元。

---

[2] 如何看待中國市場的本土競爭？研華在中國的市場定位、製造、定價及產品策略為何？

Eric Chen– *CFO* & President of General Management & Miller Chang– *President of Embedded Sector*

中國市場競爭一向激烈，過去幾年尤其著重價格與成本。公司已採取多項措施強化競爭地位。首先，研華在昆山建立在地研發及產品開發團隊，擁有超過 200 名產品經理與工程師，能為中國客戶提供在地開發的產品、製造及服務。其次，對於要求較高的工業應用，客戶除了價格，也愈來愈重視產品品質、長期供貨能力及可靠的支援服務。部分客戶因上述優勢重新選擇研華，有助於接單及營收成長。公司亦聚焦半導體設備、新能源、AI 及機器人等領域，與中國產業發展重點一致。此外，研華正規劃擴增昆山製造產能，待提案準備完成後將公布進一步細節。

---

[3] 目前部分資料中心建設出現延遲，是否會影響研華半導體或資料中心相關事業的產品需求與出貨？

Eric Chen– *CFO* & President of General Management

研華多數客戶為大型民營企業，因此管理階層預期，目前與 Edge AI 基礎設施投資相關的政策收緊對公司業務影響有限。截至目前，尚未觀察到客戶放緩或縮減投資的跡象。公司將持續密切關注客戶需求與相關政策發展，並視情況採取因應措施。